

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	易方达、交银施罗德、招商基金、富国基金、国融基金、光大保德信、浙商证券、共青城鼎睿资产管理、江苏第五公理投资、循远资产管理、重阳投资、广东正圆私募、钦沐资产、华夏久盈、平安证券、嘉实基金、华安证券、赢舟资产、东方基金、九易资本、丞毅投资、UBS、长城资管、民生证券、长江证券、国寿安保基金、尚诚资产管理、中信证券、同方证券、鑫然私募、博时基金、华泰证券、中邮证券、中泰证券（以上排名不分先后）	
时间	2025年3月20日至2025年3月24日	
地点	腾讯会议	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p>	

公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2024 年经营情况介绍

2024 年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受益于部分客户所处细分领域的需求增长、部分区域市场及客户实现突破、高配置系列产品占比提升等因素影响，公司 2024 年实现营业收入 4.07 亿元，较上年增长 17.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,848.15 万元，较上年减少 7.44%。2024 年末，公司总资产为 15.99 亿元，较上年末增长 0.86%；2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 13.16 亿元，较上年末下降 5.91%。

产品方面，2024 年，公司持续跟进客户需求，对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司测试分选机新增 PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）以及测试芯片极端发热条件下的热管理测试等测试分选功能，对产品进行持续升级。

2024 年，公司 EXCEED-9800 系列三温测试分选机实现量产，针对效率要求更高的大规模、复杂测试需求，公司持续对 EXCEED-9032 系列大平台分选机进行升级。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增

加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，持续提升海外市场服务能力，深化客户服务。公司 2024 年销售费用较上年同期增长 41.35%，公司积极拓展新客户，与客户保持紧密沟通，积极参加展会等行业相关活动。2024 年，公司扎实推进“马来西亚生产运营中心”项目建设并于 2025 年 2 月正式启用。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近市场和客户、响应客户需求。

三、调研问答

1、问：从产品结构上看，2024 年，EXCEED-9000 系列产品占收入比重的情况如何？

答：2024 年，公司 EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）收入比重提升至 25.80%，2023 年为 11.45%。

2、问：对行业复苏的感知如何？

答：2024 年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域行业企稳复苏。新能源、电动汽车及 AI 运算等相关产业的发展在一定程度上助推了半导体封装测试设备领域的发展。

3、问：2024 年在产品研发方面有什么进展？

答：一方面，是对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2024 年，公司测试分选机新增 PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）以及测试芯片极端发热条件下的热管理测试等测试分选功能；针对于效率要求更高的大规模、复杂测试需求，公司持续对 EXCEED-9032 系列大平台分选机进行升级；适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证；同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

4、问：客户一般多久下订单？

答：和之前差不多，一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态

	<p>化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。</p> <p>5、问：公司人员数量较以前年度的变化大吗？</p> <p>公司人员数量相对稳定。截至 2024 年末公司共有 365 名员工，较 2023 年末的 359 人变化较小。</p> <p>6、问：马来西亚工厂的进展如何？</p> <p>2024 年，公司扎实推进“马来西亚生产运营中心”项目建设并于 2025 年 2 月正式启用。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近市场和客户、响应客户需求。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 3 月 24 日